

杭州士兰微电子股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

为加快“SiC 功率器件生产线建设项目”的推进，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第十次会议和 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》，同意公司与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）、厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海创发展基金”）以货币方式共同出资 12 亿元认缴厦门士兰明镓化合物半导体有限公司（以下简称“士兰明镓”）新增注册资本 1,190,012,891.96 元，其中：本公司以未来向特定对象发行股份所募集的资金出资 7.50 亿元，对应士兰明镓认缴新增注册资本 743,758,057.47 元；大基金二期以自有资金出资 3.50 亿元，对应认缴士兰明镓新增注册资本 347,087,093.49 元；海创发展基金以自有资金出资 1 亿元，对应认缴士兰明镓新增注册资本 99,167,741.00 元；各方出资金额和认缴注册资本之间的差额均计入士兰明镓的资本公积。

上述事项详见公司于 2023 年 8 月 29 日和 2023 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》上披露的相关公告，公告编号：临 2023-049、临 2023-051。

二、投资进展情况

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的批准及授权，董事长陈向东先生代表公司与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）、厦门半导体投资集团有限公司签署了《增资协议》。士兰明镓已于 2023 年 11 月 3 日办理完成了相应的工商变更登记。后续公司将尽快推动各方资本金的实缴工作，以加快“SiC 功率器件生产线建设项目”的推进。

截至本公告披露日，士兰明镓最新的股权结构及实收资本情况如下所示：

股东名称	认缴出资额 (元)	截至目前 实缴出资额 (元)	持股比例 (%)	出资方式
厦门半导体投资集团有限公司	829,259,000.00	829,259,000.00	33.70	货币
杭州士兰微电子股份有限公司	1,184,869,057.47	441,111,000.00	48.16	货币
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	347,087,093.49	--	14.11	货币
厦门海创发展基金合伙企业（有限合伙）	99,167,741.00	--	4.03	货币
合计	2,460,382,891.96	1,270,370,000.00	100.00	-

基于前期的投入，目前士兰明镓已经建设了 6 吋 SiC 功率器件芯片 3000 片/月的产能，公司基于 SiC 功率器件芯片的主驱模块已实现向客户的小批量出货。预计到 2023 年年底，士兰明镓将形成 6 吋 SiC 功率器件芯片 6000 片/月的产能。

“SiC 功率器件生产线建设项目”完全达产后，士兰明镓将最终形成年产 14.4 万片 6 吋 SiC 功率器件芯片的产能。

后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日